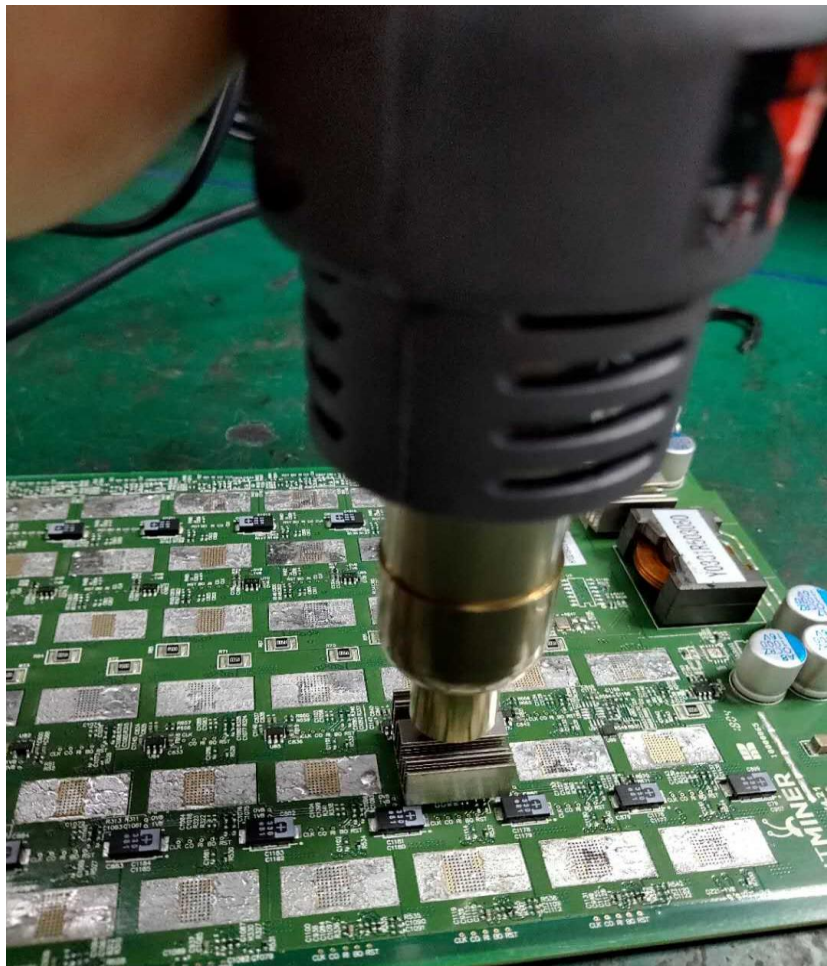


### S9 运算板片芯片拆装

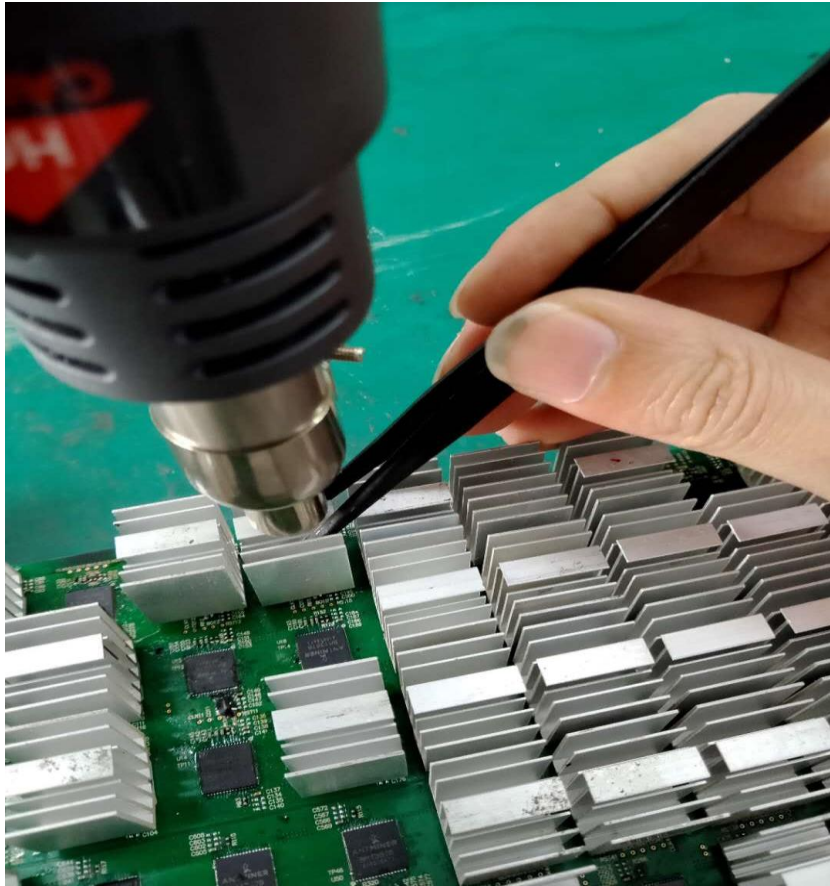
1, QUICK990A 热风枪设置: 温度(HEATER)7-8 档,风速(AIR)7-8 档



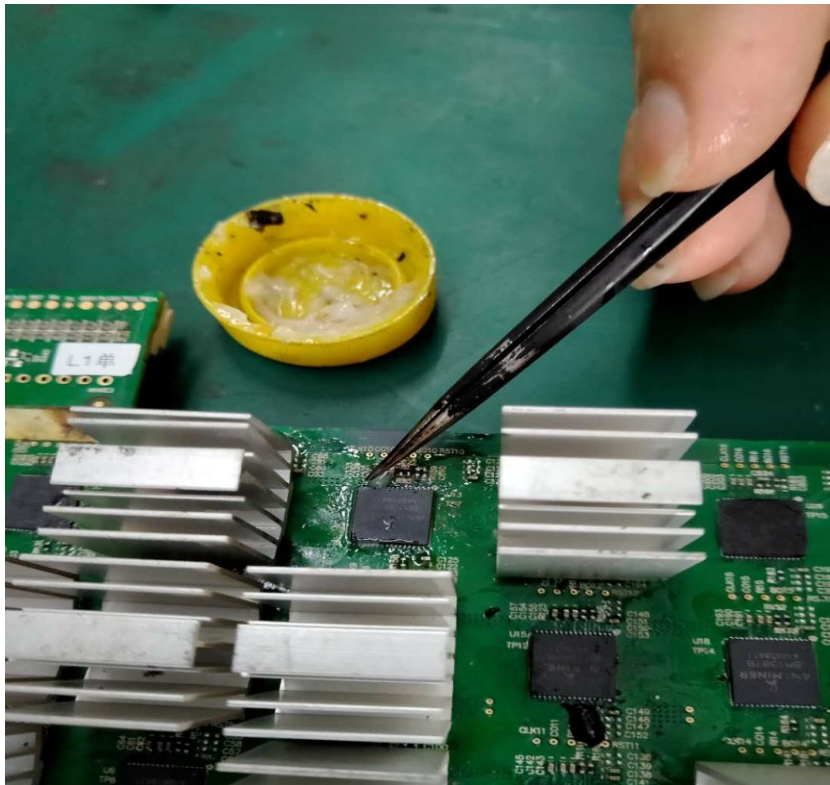
2 先取板子反面小散热片, 风枪口垂直距离散热片 6MM,加热 12 秒左右, 将散热片轻轻取下



3 在取正面散热片，风枪口距离散热片 6MM,加热 10 秒左右，用镊子给散热片斜向受力，掰下散热片



4 涂抹少许助焊剂在芯片引脚两侧

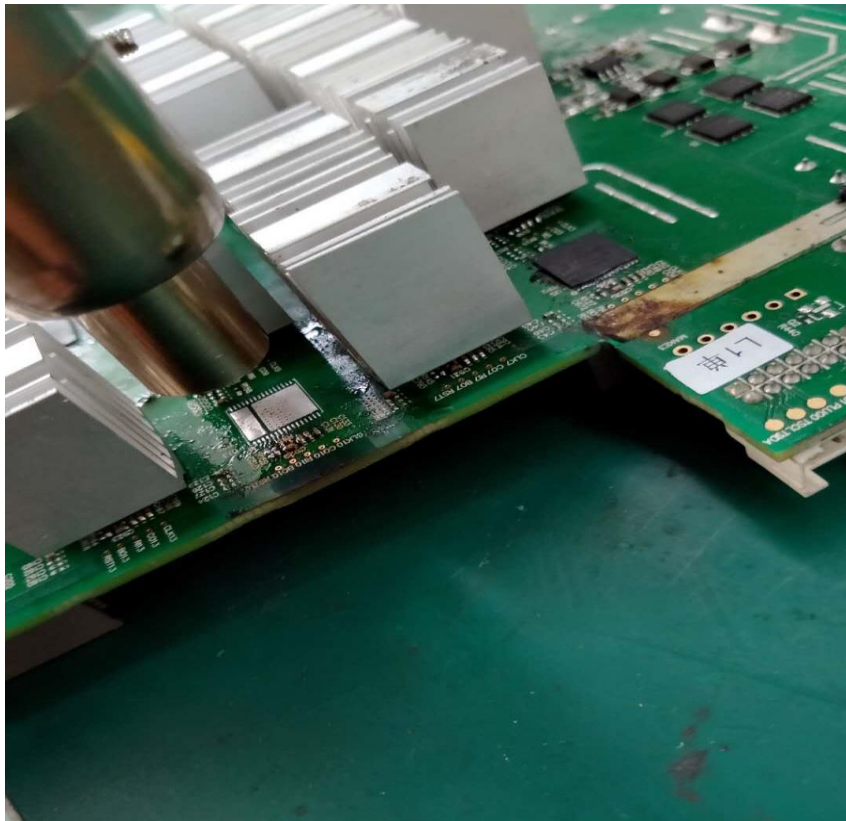




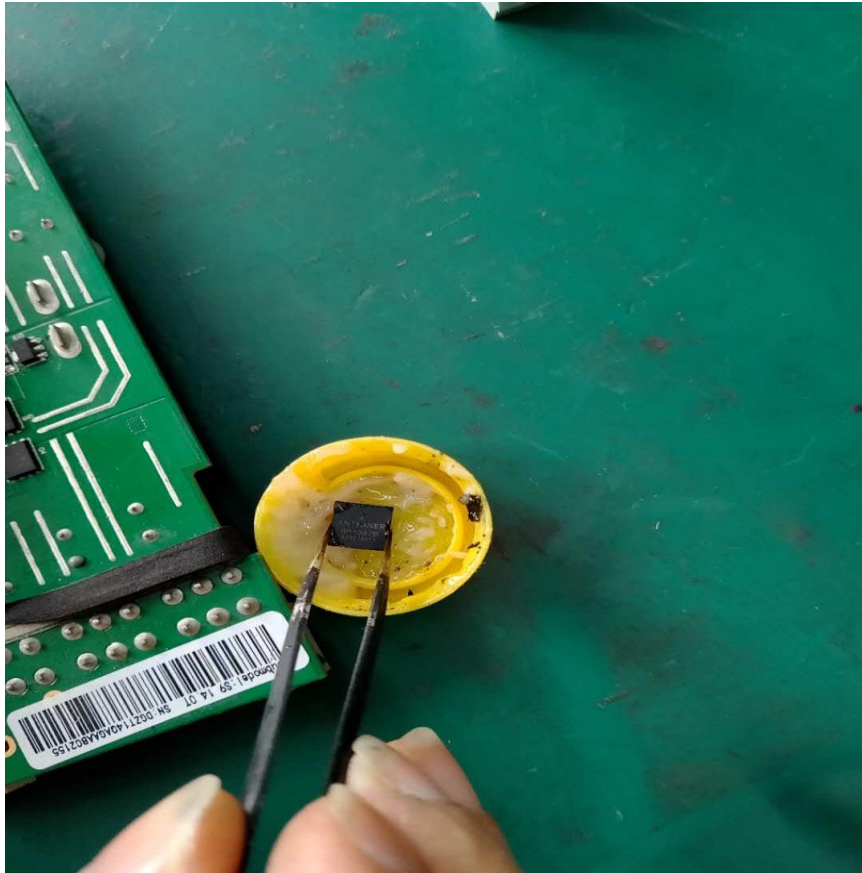
5 清除引脚焊盘上的黑胶与异物



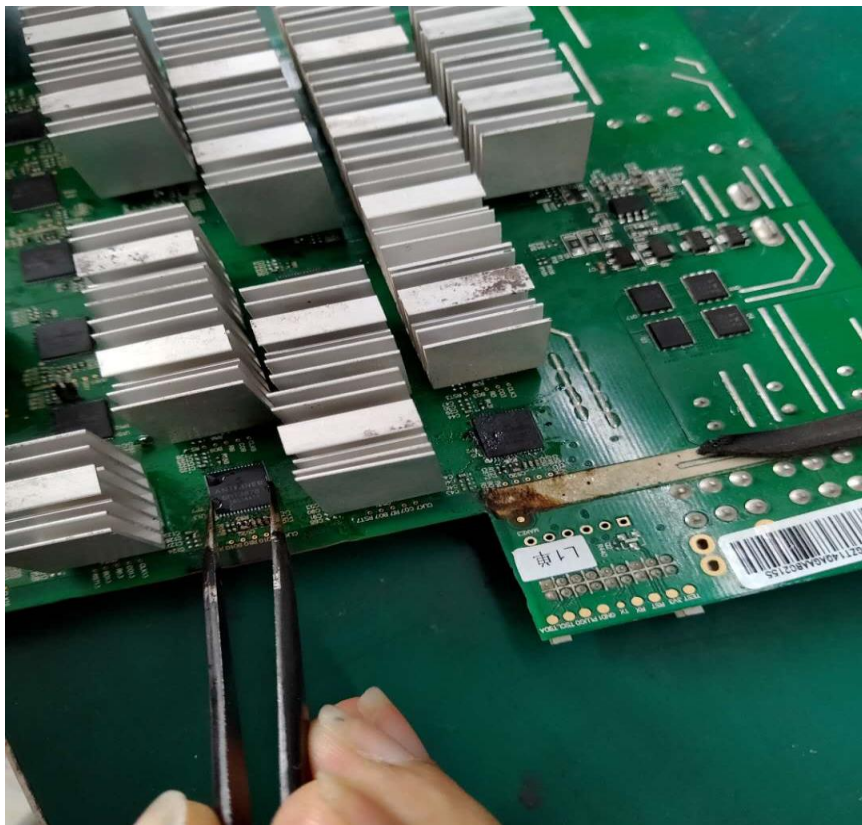
6 用风枪将 PCB 预热 3 秒



7 用风枪将芯片吹热 0.5 秒，然后去沾一下助焊膏

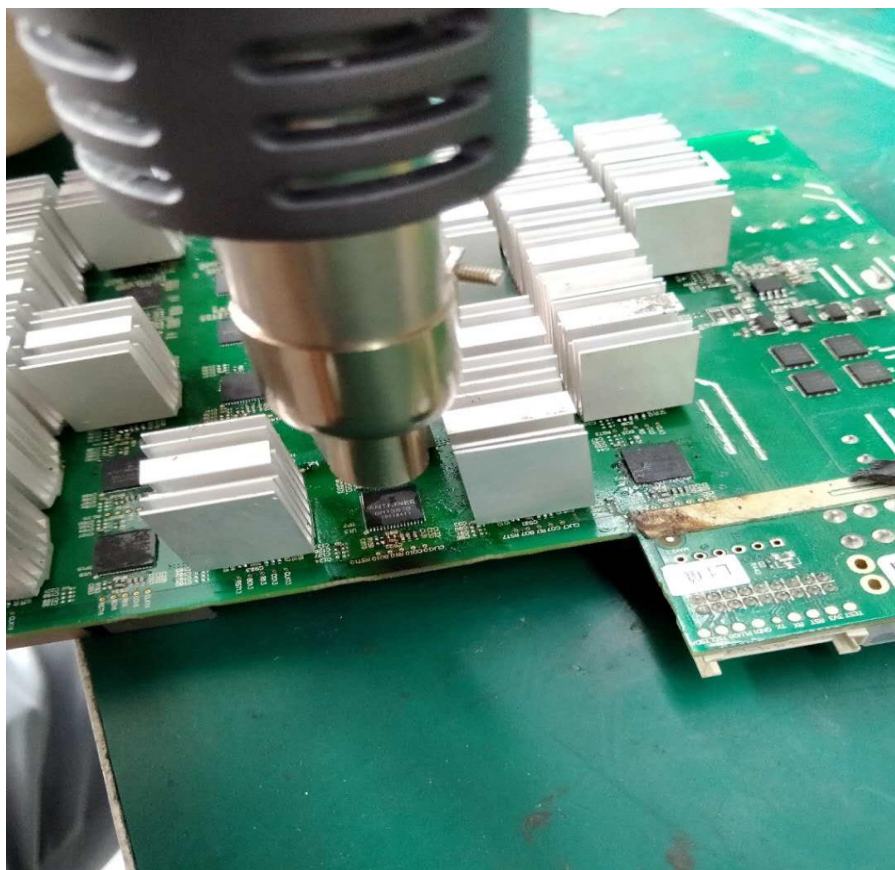


8 将芯片在 PCB 上定位，定位标准：芯片上下要把二个大焊盘覆盖，不要露白，左右引脚露白要一样多

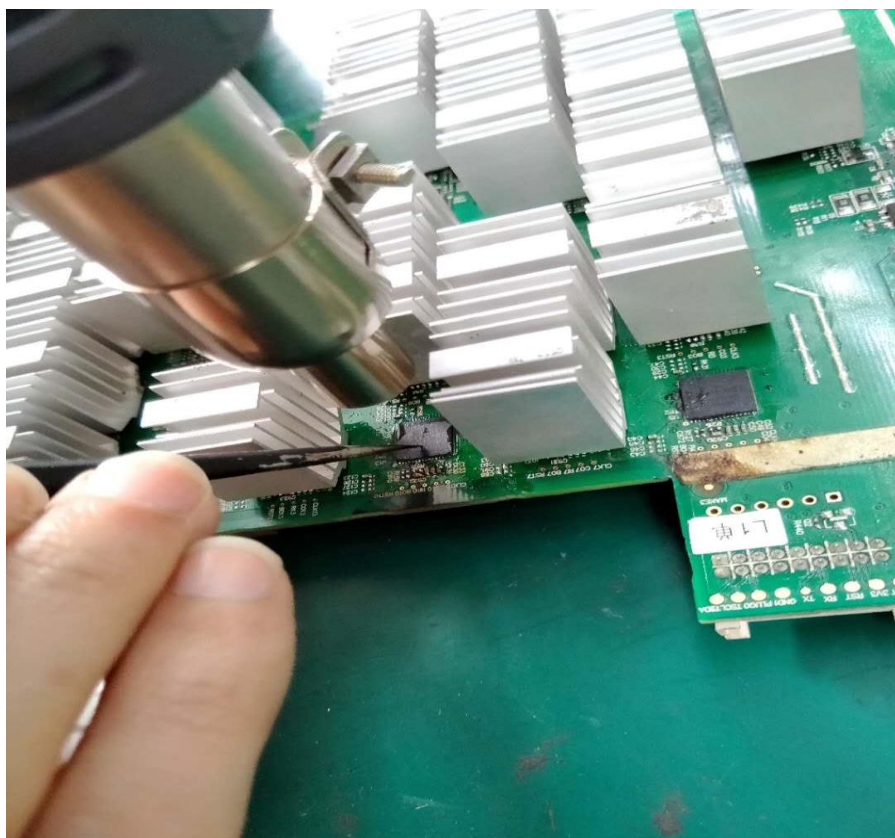




9 用风枪将芯片垂直加热 20 秒左右



10 待锡熔化完毕（焊盘发光发亮）用镊子轻压芯片，使芯片与 PCB 完全贴合



11 完成焊接如下



- 1, 运算板维修拆卸芯片, 先取小散热片, 后取大散热片。
- 2, 清除芯片背面黑胶及芯片两侧黑胶, 引脚焊盘黑胶无需用铲刀清除。
- 3, 涂抹少许助焊剂在芯片引脚两侧, 风枪温度 **450-480** 度, 风速 **7** 挡, 风枪手柄垂直 **90** 度, 加热至芯片引脚焊盘亮光泽, 用镊子将芯片翻转取下。
- 4, 清除焊盘周边黑胶及赃物, 注意周边小料及引脚损坏, 掉料。
- 5, 清除芯片周围黑胶, 用植锡工具进行对芯片植锡, 吹化, 吹化锡膏时风枪离芯片距离 **10mm**, 否则融化时达不到饱和状态。
- 6, 用棉签, 或者竹签及镊子在引脚焊盘涂抹少许助焊剂, 芯片用镊子规范摆正, 使用风枪加热吹化至锡亮光泽, 用镊子在芯片中间点轻轻挤压, 直至达到饱和状态, 挤压出来的多余锡渣清理掉, 达到不短路不连锡的状态。
- 7, (用万用表测量每个信号点, 阻值正常, 电压正常, 单板运行正常), 先加热小散热片, 直至小散热片锡融化后贴片, 贴片后, 用小风扇吹凉, 再涂抹黑胶均匀在芯片背面, 黑胶不能过多, 加热大散热片, 贴片芯片背面 (加热时间 **30** 秒左右)。